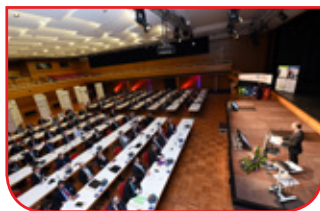


Technology**Mountains**
iNNOVATION FORUM
Smarte Technologien & Systeme

17. Februar 2016
DONAUESCHINGEN



www.innovation-forum.eu



EINIGE IMPRESSIONEN



WORUM GEHT ES?

Welche Technologietrends haben die besten Chancen? Was treibt die Branche an? Welche Standards werden sich etablieren? Welche neuen Verfahren können bald genutzt werden? Wie und wo können die Materialien für das neue Produkt oder das neue Verfahren beschafft werden?

Das TechnologyMountains Innovationsforum Smarte Technologien & Systeme bringt Unternehmer, Entwicklungsleiter und Entscheidungsträger aus der Industrie mit engagierten, kreativen Wissenschaftlern aus dem In- und Ausland an einen Tisch und bietet die Plattform für Diskussion und Austausch.

Zum 8. Mal in Folge präsentieren Referenten fortgeschrittene Ideen, neue Konzepte, Forschungsergebnisse und aktuelle Projektvorhaben in den Bereichen Sensorik & Aktorik, Miniaturisierung, Präzisionstechnologien und intelligente Systeme.

Sie erfahren aus erster Hand, welches Potenzial in den Technologien steckt. Sprechen Sie gleich vor Ort über eine mögliche Verwertung oder beraten mit den Experten über weitere, gemeinsame Entwicklungsschritte.

TechnologyMountains e. V. setzt mit dieser Veranstaltung gezielt auf branchenübergreifenden Dialog und Austausch.



FÜR BESUCHER

Erleben Sie innovative Technologie- und Technik-Highlights. Die Themen umfassen Smarte Sensorik & Aktorik, Miniaturisierung, Industrie 4.0 für KMUs, Intelligente Produkte, Smarte Fertigung & Montage und viele weitere aktuelle Themen.

Die Keynotes des Innovationsforums werden in diesem Jahr präsentiert durch Lars Knoke, Architect Strategy & Innovation und Jens Kottsieper, Technical Solution Specialist der Microsoft Deutschland GmbH sowie Dr. Ulrich Reiser, Projekt- und Gruppenleiter bei den Roboter- und Assistenzsystemen des Fraunhofer-Instituts für Produktionstechnik und Automatisierung IPA.

Sie erhalten am Tag der Veranstaltung unbegrenzten Zutritt zu über 25 Fachvorträgen und der veranstaltungsbegleitenden Ausstellung. Im Preis enthalten sind außerdem alle Unterlagen, Getränke und Pausenverpflegung sowie eine kostenfreie Parkmöglichkeit direkt am Veranstaltungsort. Auf Anfrage erhalten Sie einen WLAN-Zugang für die Dauer der Veranstaltung.

» TEILNAHMEGEBÜHR

440,- Euro

inkl. Veranstaltungsunterlagen, Pausenverpflegung und Parkplatz

10% Nachlass

für Buchungen bis zum 15.01.2016

50,- Euro

z.B. für Studenten und Doktoranden (Nachweise erforderlich)

Weitere Informationen unter

www.innovation-forum.eu

Mitglieder des Technologieverbunds TechnologyMountains erhalten im Rahmen der Mitgliedschaft eine Tagungsteilnahme gratis.

Weitere Informationen zur Mitgliedschaft finden Sie unter

www.technologymountains.de/mitgliedschaft

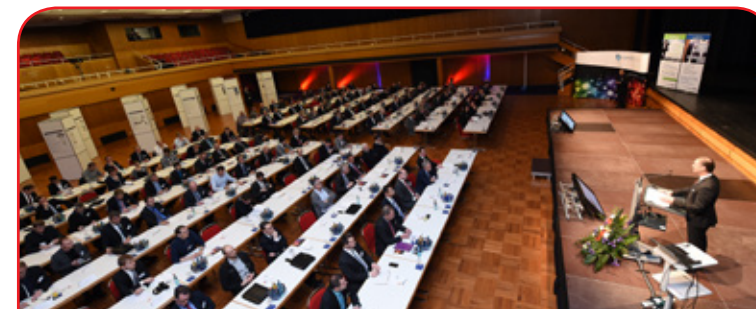
IHRE VORTEILE

» WÄHREND DES GESAMTEN TAGES ERWARTEN SIE:

- ✓ rund 30 Highlights aus den Bereichen der Smarten Technologien & Systeme
- ✓ zahlreiche Vorträge und Expertengespräche
- ✓ Inspiration für eigene Entwicklungsprojekte
- ✓ mehr als 200 Entscheidungsträger
- ✓ organisierte One-To-One Meetings
- ✓ eine forumsbegleitende Ausstellung
- ✓ Zugang zum Know-how renommierter Institute und Forschungseinrichtungen
- ✓ interessante Kontakte und neue Partner für Entwicklung, Produktion und Marketing
- ✓ spannende Gespräche in angenehmer und entspannter Atmosphäre

» AUSSTELLUNG UND VORTEILSPAKETE

Die Tagungsteilnahme als Aussteller oder gar als Premiumpartner ist eine weitere Möglichkeit für Ihr Unternehmen, für Kunden und Partner Mehrwerte zu schaffen und gegenüber den Teilnehmern sowie der Region Flagge zu zeigen. Hierfür haben wir für Sie einige Pakete mit attraktiven Leistungen geschnürt. Mehr Informationen zu den Preisen und Vorteilsangeboten erhalten Sie auf Seite 9.



DAS PROGRAMM

ab 9.00 Uhr	Registrierung	
10.00 Uhr	Begrüßungstalk mit:	
	<i>Thomas Albiez</i>, Hauptgeschäftsführer der IHK-Schwarzwald-Baar-Heuberg <i>Bernhard Kaiser</i>, Bürgermeister der Stadt Donaueschingen <i>Dr. Harald Stallforth</i>, Vorstandsvorsitzender des TechnologyMountains e. V. <i>Uwe Remer</i>, geschäftsführender Gesellschafter der 2E mechatronic GmbH & Co. KG <i>Prof. Dr.-Ing. Roland Zengerle</i>, Institutsleiter der Hahn-Schickard-Gesellschaft für angewandte Forschung e. V. Freiburg	
10.30 Uhr	Keynotes	
	HoloLens – Augmented Reality? Virtual Reality? go beyond with MixedReality <i>Lars Knoke</i>, Architect Strategy & Innovation, Microsoft Deutschland GmbH <i>Jens Kottsieper</i>, Technical Solution Specialist, Microsoft Deutschland GmbH Die (Service-)Roboter von morgen – aus den Fabrikhallen in den Alltag <i>Dr. Ulrich Reiser</i>, Projekt- und Gruppenleiter Roboter- und Assistenzsysteme, Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA	
12.00 Uhr	Mittagessen / Diskussion mit den Experten / Fachausstellung / B2B-Gespräche	
13.00 Uhr	Precision Technologies & Prototyping	Smart Components
	Kontinuierlicher 3D-Druck für die Serienfertigung <i>Claus Aumund-Kopp</i>, Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung IFAM Zwei-Photonen-Polymerisation auf Wafer-Level-Scale <i>Eric Markweg</i>, TETRA Gesellschaft für Sensorik, Robotik und Automation mbH Verbindungstechnologien für die 3D Montage - Eine Evaluierungsstudie <i>Sascha Lohse</i>, Finetech GmbH & Co. KG Industrial production of micro parts by Micro Laser Sintering <i>Matthias Winderlich</i>, 3D MicroPrint GmbH	Hochintegrierte Stromsensoren für Leistungselektronik mit hoher Leistungsdichte in der Elektromobilität <i>Dr. Rolf Slatter</i>, Sensitec GmbH Multi-axial force measurement with optics <i>Ákos Dömötör</i>, OptoForce Ltd RFID als eine Kommunikationsplattform im Internet of Things <i>Reinhard Jurisch</i>, Micro-Sensys GmbH Aus Wärme Strom erzeugen - Die nachhaltige Stromversorgung für das Internet of Things <i>Frederick Lessmann</i>, otego spin-off project, Karlsruher Institut für Technologie KIT
14.00 Uhr	Kaffeepause / Diskussion mit den Experten / Fachausstellung / B2B-Gespräche	

DAS PROGRAMM

15.00 Uhr	Precision Manufacturing & Assembly	Smart Systems
	Smart Adhesives for highly automated Active Alignment processes <i>Maximilian Baum</i>, DELO Industrie Klebstoffe GmbH und Co. KGaA Planung und Inbetriebnahme sensorgeführter Mikromontageprozesse effizient gestalten <i>Sebastian Haag</i>, Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie IPT UV-Laser und Strahlsysteme zur flächigen Bearbeitung in der Display-Industrie <i>Dr.-Ing. Oliver Haupt</i>, Coherent LaserSystems GmbH & Co. KG Mit neuen innovativen Technologien zu neuen Komponenten für einen komplexen Mikrosensor zum kontinuierlichen Glukosemonitoring <i>Dr. Hans-Joachim Freitag</i>, CiS Forschungsinstitut für Mikrosensorik GmbH	VIP – Vision in a Package <i>Dr. Christiane Gimkiewicz</i>, Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique CSEM SA Sichere und durchgängige Kommunikationslösungen für Industrie 4.0 <i>Prof. Dr.-Ing. Axel Sikora</i>, Hahn-Schickard-Gesellschaft für angewandte Forschung e. V. Funkbasiertes MDE-System zum Nachrüsten <i>Michael Wigant</i>, WERMA Signaltechnik GmbH & Co. KG Power-by-Light: An Innovative Power Supply Solution for Smart Systems <i>Dr. Henning Helmers</i>, Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE
16.00 Uhr	Kaffeepause / Diskussion mit den Experten / Fachausstellung / B2B-Gespräche	
16.30 Uhr	Embedded Technologies & Measurement	Innovation Management & Cooperation
	Die Leichtigkeit des taktilen Messens <i>Bernhard Lichtenauer</i>, DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH Kombinierte Druck- und Näherungssensorik <i>Dr. Bernhard Brunner</i>, Fraunhofer-Institut für Silicatforschung ISC Zerstörungsfreies Prüfen mittels Infrarot-Thermografie <i>Peter Nicolaus</i>, InfraTec GmbH MID - Intelligente AVT im 3D-Format <i>Uwe Remer</i>, 2E mechatronic GmbH & Co. KG	Paradox Mittelstandsinnovation <i>Marin Baraba & Bodo Henkel</i>, Dekadi Baraba & Henkel Innovation Consultants PartG OurPlant. The Prime Micro Assembly Platform. <i>Uwe Schulz</i>, Häcker Automation GmbH Prozesse werden zu Apps - Wie Sie Anwendungen einfach mobilisieren <i>Jens Vanicek</i>, ALL4NET GmbH Verbundprojekte als Erfolgsfaktor für Smarte Kunststoffprodukte <i>Siegfried Kaiser</i>, Kunststoff-Institut Südwest GmbH & Co. KG
17.30 Uhr	Gemeinsames Abendessen / Get-together	

ANMELDUNG & INFORMATIONEN

» ANMELDUNG

Anmeldung bitte per E-Mail an giesser@technologymountains.de

per Telefax an: +49 (0) 7721 922-9181

oder online unter www.technologymountains.de/anmeldung



» IHRE ANSPRECHPARTNER

Marcel Trogisch

Telefon: +49 (0) 7721 922-170

E-Mail: trogisch@technologymountains.de

Martin Preil

Telefon: +49 (0) 7721 922-206

E-Mail: preil@technologymountains.de

» VERANTWORTLICHER VERANSTALTER

TechnologyMountains e. V., Romäusring 4, 78050 Villingen-Schwenningen

Vorstandsvorsitzender: Dr. Harald Stallforth

Vereins-Nr. VR 1289, Amtsgericht Villingen-Schwenningen

» AUSGEZEICHNET



IHRE INVESTITION

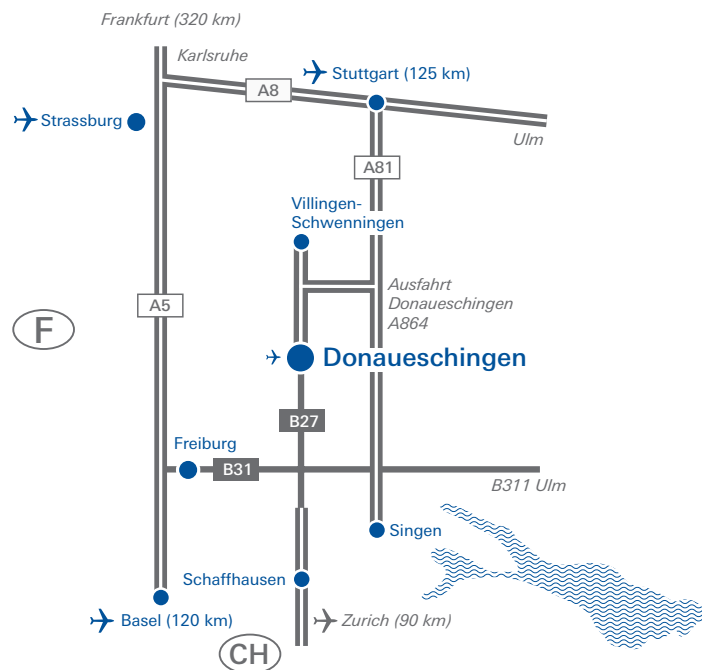
	Aussteller	Vorteilspack Basic Plus	Vorteilspack Business	Vorteilspack Professional
Investition		1.500,-	2.400,-	3.900,-
3 m² Ausstellungsfläche inkl. eine Person als Standbetreuung	590,-			
4 m² Ausstellungsfläche inkl. eine Person als Standbetreuung	780,-			
6 m² Ausstellungsfläche inkl. zwei Personen als Standbetreuung	980,-			
Eintrittskarte zum Innovationsforum		✓	✓	✓
3 m² Ausstellungsfläche			✓	
6 m² Ausstellungsfläche				✓
Firmenlogo auf Homepage*		✓	✓	✓
Anzeige im Tagungsband* DIN A5, farbig		✓	✓	
Umschlagsanzeige im Tagungsband* DIN A5, farbig				✓
Einleger im Tagungsband*			✓	✓
Firmenlogo auf dem Umschlag des Tagungsbandes*			✓	✓
Firmenlogo auf dem Veranstaltungsflyer*				✓
Zusätzliche Eintrittskarten z.B. für Kunden und Geschäftspartner usw.		2 Stk.	3 Stk.	6 Stk.

* Nur im Rahmen des jeweiligen Paketes buchbar. Alle Preise zzgl. 19% MwSt.

Early-Bird-Rabatt bis zum 15.01.2016	10% Nachlass auf die Teilnahmegebühr
TechnologyMountains-Mitglieder	10% Nachlass + eine Freikarte
Studenten und Doktoranden (Entsprechender Nachweis erforderlich)	50,- Euro Eintritt fürs Innovationsforum (brutto)



LOCATION ANFAHRTSSKIZZE



» ANSCHRIFT

Donauhallen Donaueschingen
An der Donauhalle 2, 78166 Donaueschingen
Telefon: +49 (0) 771 897 819-0
info@donauhallen.de

» PARKMÖGLICHKEITEN

Auf dem Vorplatz stehen 100 Stellplätze zur Verfügung.
Im gesamten Innenstadt-Bereich stehen weitere
Parkmöglichkeiten zur Verfügung.

LOCATION ORT & ANFAHRT

» AUTO

Donaueschingen liegt verkehrsgünstig im Schnittpunkt von drei Bundesstraßen:

B27 Stuttgart – Schaffhausen / B31 Freiburg – Lindau /
B33 Offenburg – Konstanz

In unmittelbarer Nähe verläuft die Bundesautobahn A81 Stuttgart-Singen, die über einen Zubringer A864 in wenigen Minuten erreichbar ist. Die Donauhalle befindet sich zentral im Stadtkern, ein paar Gehminuten vom Bahnhof entfernt.

» BAHN

Donaueschingen ist ein Bahnknotenpunkt. Es halten alle Züge.

» FLUGZEUG

Regionalflugplatz Donaueschingen
Flughafen Stuttgart: ca. 120 km
Flughafen Zürich / Schweiz: ca. 140 km





TechnologyMountains iNNOVATION FORUM

Smarte Technologien & Systeme

EINE VERANSTALTUNG VON



TECHNOLOGYMOUNTAINS
Der Technologieverbund im Südwesten



IHK Industrie- und Handelskammer
Schwarzwald-Baar-Heuberg

17. Februar 2016

DONAUESCHINGEN

www.innovation-forum.eu